

JAPAN PACKAGE DESIGN AWARDS 2023

大阪成蹊大学 特別企画展

「日本パッケージ
デザイン大賞2023」展

6.19 MON - 6.30 FRI

※6月24日(土)、6月25日(日)は休廊

OPEN 12:00 - CLOSE 18:00

大阪成蹊大学 芸術学部棟(南館)
1Fギャラリー〈space B〉

主催:大阪成蹊大学 芸術学部/教育研究支援センター
後援:公益社団法人 日本パッケージデザイン協会



JPDA

JAPAN PACKAGE DESIGN ASSOCIATION

JPDA

大阪成蹊大学 特別企画展 「日本パッケージデザイン大賞2023」展

6.19 MON - 6.30 FRI

※6月24日(土)、6月25日(日)は休廊

OPEN

12:00 - 18:00

CLOSE

大阪成蹊大学 芸術学部棟(南館) 1Fギャラリー <space B>

JAPAN PACKAGE DESIGN AWARDS 2023

「日本パッケージデザイン大賞」は、公益社団法人日本パッケージデザイン協会主催のコンペティション事業として隔年に開催されます。パッケージというデザイン領域のプロフェッショナルたちが集い、公募により広く作品を募集して選考する、デザイン性や創造性を競うコンペティションです。「日本パッケージデザイン大賞2023」は、応募総数1060点を数えました。59名の一次審査員による第一次審査において、416点の入選作品が選ばれ、第二次審査においては協会会員審査員10名に、前回大賞受賞者1名および外部特別審査員4名を加えた二次審査員15名の討議にて、合計31点の入賞作品を決定いたしました。本展では大賞に輝いた「資生堂 BAUM」をはじめ、金賞7点、銀賞12点、銅賞10点、特別審査員賞4点を含めた入賞作品を展示いたします。「今」を代表する最新のパッケージを是非ご覧ください。



大賞/資生堂クリエイティブ(株) BAUM



金賞・特別審査員賞(太刀川英輔) / 株式会社ロッテ Loopキシリトールガム



金賞・特別審査員賞(左合ひとみ) / ソニーグループ株式会社 オリジナルブレンドマテリアル [WV-1000XM4]パッケージ



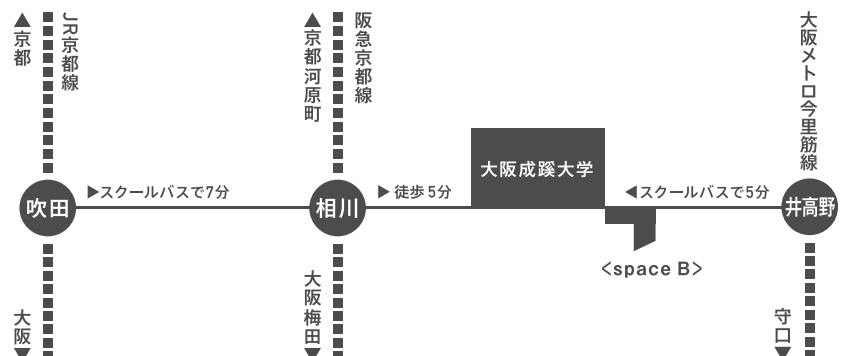
銅賞・特別審査員賞(花澤裕二) / ウェストロック株式会社 エコパック



特別審査員賞(辻愛沙子) / Study and Design IRODORI CHOCOLATE

アクセス

阪急京都線「相川」駅 東改札口を出て徒歩5分
JR「吹田」駅、大阪メトロ「井高野」駅から
スクールバスをご利用いただけます。
バスの時刻表は大学ホームページにてご確認ください。
駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。
<https://osaka-seikei.jp/school-bus/>



 **大阪成蹊大学**
OSAKA SEIKEI UNIVERSITY

お問い合わせ

大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学 教育研究支援センター 〒533-0007 大阪府大阪市東淀川区相川13-10-62 | 電話 06-6829-2630 | メール spaceb@osaka-seikei.ac.jp | ウェブサイト <https://univ.osaka-seikei.jp>